檔　　號:
保存年限:

財團法人臺灣營建研究院 書函

地址：231新北市新店區中興路二段190號11樓
聯絡人：陶羿彣
電話：02-89195098
電子郵件：taoyiwen@tcri.org.tw

受文者：教育部

發文日期：中華民國115年11月13日
發文字號：營建工字第1150002952號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：研討會議程表（1150013P000609_1150002952_115D2001973-01.pdf）

主旨：敬邀貴單位派員參加本院舉辦「2026台灣混凝土應用與技術研討會」，請查照。

說明：本院將於115年12月22日(星期二)臺灣科技大學國際大樓一樓101會議室，舉辦「2026台灣混凝土應用與技術研討會」，共同分享國內外混凝土的最新耐久性技術、減碳策略及現場施工自動化等最新研究成果，提供與會先進學習及交流的平台，期望提升國內混凝土科技研究與創新發展，為營建產業發展提供更大助益，邁向永續發展之目標，研討會課程內容及報名表如附件所示，敬邀貴單位派員參加。

正本：同受文者
副本：工程服務組 電子公文交換章 2026/11/13 16:39:11

1150117916 收文日期:115/11/16